

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2018-026

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 关于深圳证券交易所 2017 年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 421 号）（以下简称“问询函”），现根据问询函的要求，对问询函相关问题做出回复并披露如下：

一、你公司 2017 年度计入当期损益的政府补助金额为 2,616.28 万元，同比增加 735.29%，请你公司补充披露上述政府补助发生的背景、原因以及相关会计处理，并说明会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师发表专业意见。

回复：

公司2017年度计入当期损益的政府补助金额为2,616.28万元，同比增加735.29%，主要是由于本公司之全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）承担了“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（以下简称02专项）国家科技重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目（项目编号：2011ZX02710），并与由北京市经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会组建的专项牵头组织单位专项实施管理办公室签订了任务合同书。任务合同书中对项目研究内容、成果、知识产权、技术指标及研发经费来源等均进行了约定。

2017年4月，专项实施管理办公室组织专家组对广东丹邦承担的02专项课题项目进行了整体验收。包括任务指标验收、财务验收两部分。验收结果表明广东丹邦完成了任务书规定的研发内容，各项技术指标、产业化销售指标、知识产权指标、人才队伍建设及平台指标等均达到任务书考核要求。同时财务验收明确了审定金额、已拨付金额及待拨付金额。并于2018年3月取得重大专项实施管理办

公室出具的国家 02 专项项目证明。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：（一）企业能够满足政府补助所附条件；（二）企业能够收到政府补助。同时，根据上市公司执行企业会计准则监管问题解答，中国证券监督管理委员会会计部函[2013]232号中是否可以按照应收确认政府补助的解释，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额计量。

本公司之全资子公司广东丹邦承担的02专项课题项目研究，已经专项实施管理办公室整体验收，满足取得政府补助所附条件；同时根据任务合同约定、相关文件要求（《财政部关于下达“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项2011年预算的通知》（财教[2011]179号）、《关于02专项2011年度项目立项批复的通知》ZX02[2011]003号）、专项实施管理办公室验收证明文件等综合判断，广东丹邦预计能够收到上述待拨付政府补助。故我们认为，02专项待拨付政府补助部分满足《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，并根据具体审核情况将待拨付政府补助划分为与资产相关和与收益相关的政府补助。其中与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；与收益相关的政府补助直接计入当期损益。

**二、2017 年末，你公司开发支出账面余额 5,902.21 万元，较期初增加 50.85%，请说明开发支出增长的原因，结合各个研发项目的具体进展说明本期资本化的判断依据以及会计处理的合规性。请年审会计师发表专业意见。**

回复：

**1、开发支出增涨的具体原因**

2017年度，公司在立足于自身主营业务技术水平提升的同时在产业链的上下游展开了重点研究，主要集中在以下几个方向：

**1) 主营业务相关研究**

主要集中在对FCCL、FPC、COF基板及COF产品的新工艺、新技术、新产品开

展研究，不断提升主营业务技术水平，保持传统核心技术竞争优势。布局了诸如“一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板技术”、“差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数的组合优化”以及“FCCL 涂布法生产中涂层厚度的影响因素研究”，“激光开槽法制作FPC 嵌入式微细线路技术研究”等项目。研究更先进的工艺技术，不断突破传统工艺制作微细线路的工艺极限及封装水平，进一步提升产品关键性能指标，保持先进性，更好地适应当今电子产品小型化、薄型化、轻量化的发展趋势。

2) 功能型PI膜及其深加工产品（PI碳化膜）相关研究方向。

PI膜是公司主营业务产业链上游最重要的原材料，实现关键原材料的自产，一方面可以降低生产成本、显著提高利润率，另一方面还可以通过外销形成新的收入、利润增长点。2017年度，公司在通用型PI膜生产的基础上，继续向PI膜功能化方向展开研究，不断丰富PI膜产品的品种、扩大应用领域，满足市场多元化需求。布局了诸如“黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”、“耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”以及“微电子级超薄（12.5μ m以下）聚酰亚胺薄膜技术”等功能型PI膜研发项目，这些项目产品在光学、电子电工、航空航天等领域都有着广阔的应用前景。

依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。开展PI碳化膜方面的研究，同时为未来的产业化布局提供技术储备，是公司前瞻性研究的一个重点方向，为此布局了诸如“柔性多层（量子）碳基薄膜材料”以及“卷状连续石墨烯膜自动化生产工艺开发”等项目，对PI碳化膜的自动化生产工艺、能隙开启与调控以及复合材料等方面展开专门的研究，拓宽新材料的应用领域，抢占高端材料制高点。

2、2017年末研发项目具体进展情况

| 序号 | 项目                    | 研发内容                                                      | 项目进展                               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1) | 微细凹印涂布法中聚酰亚胺膜厚的控制技术研究 | 通过单因素实验法进行科学的实验设计，得到涂布量与各因素之间的变化规律，为微细凹印涂布生产中的涂布厚度的精准控制提供 | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作 |

| 序号  | 项目                             | 研发内容                                                                                            | 项目进展                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                | 参数依据                                                                                            |                                          |
| 2)  | 防离子迁移的组合物及制备方法、无胶基材及制备方法       | 提供一种防离子迁移的组合物及其制备方法，从而提高聚酰亚胺膜的绝缘性能以及与金属层的剥离强度，满足高密度挠性电路板对其无胶基材的性能要求                             | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 3)  | 一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板          | 提供一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板以及柔性印刷电路板，满足柔性基板连接电子元件时对安装强度及耐热性的需求                                      | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 4)  | 微电子级超薄（12.5 $\mu$ m以下）聚酰亚胺薄膜技术 | 开发出具有自主知识产权的微电子封装级PI薄膜核心技术并实现产业化。产品性能满足高频、高密度柔性封装基板对材料的特性要求。                                    | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 5)  | 柔性多层（量子）碳基薄膜材料                 | 开发出具有自主知识产权的柔性多层石墨烯（量子）碳基半导体薄膜材料核心技术并实现产业化。产品性能满足日益小型化、高发热量电子元器件的散热需求，同时，实现石墨烯带隙的开启与调控，具备半导体性能。 | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告、专利申报以及样品开发等工作  |
| 6)  | 柔性封装基板用碱显影感光阻焊油墨技术             | 改善现有技术的不足，提供一种FPC用碱显影感光阻焊油墨其硬度、显影能力、力学性能、耐化性以及耐弯曲性等能充分满足现代微细线路FPC用阻焊油墨层的要求。                     | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 7)  | 柔性封装基板用化学镀镍磷合金技术               | 提供一种化学镀镍磷合金的镀液，以解决现有的印制电路板镍磷合金层弯折性能差的技术问题                                                       | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 8)  | 差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数的组合优化    | 对差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数进行组合优化，制作出理想线路外形且线路厚度可控的微细线路FPC                                          | 2017年末，该项目已经结题验收，并完成技术总结报告、专利申报以及样品开发等工作 |
| 9)  | 基于LCP-PI薄膜的超薄芯片制作及封装技术         | 开发出芯片的减薄、拿持、转移、固定以及将超薄芯片集成到柔性聚合物（LCP或PI）基板上/中的技术。                                               | 2017年末，该项目已经结题验收，并完成技术总结报告、专利申报以及样品开发等工作 |
| 10) | 有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究           | 有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究该粗化液对PI薄膜表面粗化效果好并能有效地去除薄膜表面油污及其他污渍。                                         | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 11) | FCCL涂布法生产中涂层厚度的影响因素研究          | FCCL涂布法生产中影响涂层厚度质量的因素分析及解决方案。                                                                   | 2017年末，该项目已结题验收，并完成技术总结报告以及专利申报等工作       |
| 12) | 黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺开发                 | 提供一种黑色PI膜的制备方法。其制品表面黑色均匀度高且两面光泽度一致，光泽度低，                                                        | 依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行                   |

| 序号  | 项目                       | 研发内容                                           | 项目进展                           |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                          | 遮光效果好。                                         | 全面性能测试阶段                       |
| 13) | 耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发          | 提供一种耐电晕聚酰亚胺薄膜制备方法                              | 依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段 |
| 14) | 激光开槽法制作FPC嵌入式微细线路技术研究    | 开发一种制作柔性电子电路的新型技术，解决现有生产工艺的局限性。                | 依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段 |
| 15) | 原子层沉淀法（ALD）制备聚酰亚胺柔性覆铜板技术 | 将ALD法引入PI树脂基柔性覆铜板的制造，利用ALD法的优势，克服传统涂布法工艺中存在的弊端 | 依据产品方案和工艺进行生产试验，及对样品进行全面性能测试阶段 |

### 3、本期资本化的判断依据以及会计处理

根据企业会计准则及相关规定，公司将开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中：1）研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。2）开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目开发阶段的支出，归集于研发支出科目，符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。在项目提交专利申请并取得受理函之日起转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

内部研究开发项目开发阶段的支出资本化的条件是：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司根据企业会计准则相关规定对内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段进行了严格的划分，会计处理符合企业会计准则的相关规定。

三、2017 年度，你公司营业收入为 3.17 亿元，同比增长 17.14%，但扣除非经常性损益后的净利润仅为 10.04 万元，同比下降 99.54%，请说明营业收入增长但扣非后净利润大幅下降的原因。

回复：

本公司2017年度营业收入3.17亿元，同比增长17.14%，但扣除非经常性损益后的净利润仅为10.04万元，同比下降99.54%。主要影响因素列示如下：

单位：万元

| 项目      | 本期数       | 上期数       | 变动金额      | 变动比例     |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入    | 31,715.85 | 27,075.67 | 4,640.18  | 17.14%   |
| 营业成本    | 20,181.46 | 17,061.17 | 3,120.29  | 18.29%   |
| 税金及附加   | 749.59    | 546.49    | 203.10    | 37.17%   |
| 销售费用    | 580.59    | 601.95    | -21.36    | -3.55%   |
| 管理费用    | 5,757.98  | 5,865.98  | -108.00   | -1.84%   |
| 财务费用    | 5,105.41  | 71.42     | 5,033.99  | 7048.21% |
| 资产减值损失  | -1,162.35 | 613.68    | -1,776.03 | -289.41% |
| 减：所得税费用 | 525.24    | 166.02    | 359.22    | 216.38%  |

上述数据可以看出，造成公司本年度扣非后净利润大幅下降的因素主要是财务费用大幅增加所致。2017年度公司财务费用较上期有较大增加，主要系由于1）本公司产品销售以出口为主，主要以美元进行结算，使得各期末公司账面存在较大的应收外币货款。而2016年度、2017年度美元汇率波动较大，造成公司财务费用汇兑损益波动较大；2）2017年度公司增加了向金融机构借款加大产业布局投入（TPI薄膜碳化技术改造项目），加大设备采购的资金投入，使得2017年银行借款利息大幅增加所致。

四、你公司 2016 年度经营活动现金流量净额为净利润的 5.65 倍，2017 年度为 8.38 倍，请说明你公司经营活动现金流量净额大幅超出净利润的原因及合理性。

回复：

2017年度，公司净利润调节为经营活动现金流量列示如下：

| 项 目                                  | 单位：万元     |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                                      | 本期数       | 上期数       |
| 净利润                                  | 2,537.36  | 2,458.99  |
| 加：资产减值准备                             | -1,162.35 | 613.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 11,528.08 | 8,624.49  |
| 无形资产摊销                               | 877.67    | 788.42    |
| 长期待摊费用摊销                             | 30.31     | 20.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“－”号填列） |           | 3.37      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 4,017.57  | 1,994.42  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | 213.24    | -77.00    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                     | -2,275.09 | -717.43   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                | 6,686.69  | 1,142.02  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                | -1,190.31 | -953.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 21,263.18 | 13,897.37 |

上述净利润调节为经营活动现金流量是以净利润为出发点，通过调整不涉及现金或不属于经营活动相关的收入、费用等项目得出。通过上述调整过程可以看出，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的原因主要是由于本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、财务费用利息支出以及2017年加大客户回款催收力度客户回款增加等因素综合影响所致。

综上所述，公司报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异是合理的，符合公司实际运营情况。

五、根据你公司披露的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大股东及其附属企业东邦科技（香港技术）有限公司 2017 年期末非经营性占用你公司资金余额为 114.3 万元，请说明形成占用的具体原因与资金用途，以及你公司履行的审议程序。

回复：

应付关联方款项列示如下：

单位：万元

| 项目名称  | 关联方            | 期末金额   | 款项性质 |
|-------|----------------|--------|------|
| 其他应付款 | 东邦科技（香港技术）有限公司 | 114.30 | 代垫费用 |

上述数据可以看出，2017年末公司账面存在其他应付关联方东邦科技（香港技术）有限公司代垫款114.30万元。该部分代垫款形成主要是由于本公司之全资子公司丹邦科技（香港）有限公司为境外销售的窗口公司，其职能是充分利用香港发达的贸易及结算环境，承担公司对海外客户、供应商的销售收款及付款的作用，自身无生产经营，在其未预留充足日常运营资金且境内资金无法及时支付时，考虑到结算的及时性会申请由关联方予以垫付。

六、2017 年度，你公司向前五名客户的合计销售金额占年度销售总额的 66.29%，向前五名供应商的合计采购金额占年度采购总额的 43.34%，请结合你公司的经营现状和业务模式，说明你公司是否存在高度依赖少数客户和供应商的情形。

回复：

1、2017年度，前五名客户销售情况列示如下：

单位：万元

| 客户  | 销售额      | 占年度销售总额比例 |
|-----|----------|-----------|
| 第一名 | 5,277.65 | 16.83     |
| 第二名 | 4,163.69 | 13.28     |
| 第三名 | 3,862.47 | 12.32     |
| 第四名 | 3,754.02 | 11.97     |

| 客户  | 销售额       | 占年度销售总额比例 |
|-----|-----------|-----------|
| 第五名 | 3,727.61  | 11.89     |
| 合计  | 20,785.44 | 66.29     |

本公司主营业务是 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产与销售。产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，公司与众多国际跨国公司和专业厂商建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国际高端柔性印制电路板行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。公司的客户按地区可划分为日本、欧美、东南亚及香港，主要包括国际顶尖电子信息产品生产商或代理商，其中具有国际影响力的终端客户如索尼、日立、佳能、日本电产、松下、三洋电机、欧姆龙等。

由于公司客户主要是国际顶尖电子信息产品生产商或代理商，产品直接需求方较为分散且均是国际顶尖电子信息产品制造商。同时，公司客户群体不存在向单个客户销售比例超过销售总额 50%的情况，第一大客户销售占比只在16.83%。故公司不存在高度依赖少数客户的情形。

2、2017年度，前五名供应商采购情况列示如下：

单位：万元

| 供应商 | 采购额      | 占年度采购总额比例 |
|-----|----------|-----------|
| 第一名 | 1,728.99 | 18.10     |
| 第二名 | 1,006.30 | 10.53     |
| 第三名 | 622.47   | 6.51      |
| 第四名 | 452.60   | 4.74      |
| 第五名 | 330.93   | 3.46      |
| 合计  | 4,141.29 | 43.34     |

公司主要生产所需原材料品种较多，主要包括铜箔、PI膜、保强板、粘合剂、芯片及器件等，其中 PI 膜大部分由境外进口，保强板、粘合剂、芯片及器件大部分由境内采购，铜箔境内、境外采购数量相当。公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，在多年的经营中，公司已与多家原材料生产厂商建立

了长期稳固的合作关系，且每种主要原材料供应商数量保持两家以上，原材料来源和质量有保证。与此同时，珠三角地区电子元器件生产供应厂商众多，元器件供应充足。

同时，公司以往产业链上游最重要的原材料PI膜均是通过外购取得，现在公司实现了上游关键原材料PI膜自产，进一步减少了该种材料对国外供应商的依赖程度，主要原材料铜箔、芯片及器件等市场竞争比较充分，供应充足，可选择性较强。故在采购方面，公司材料采购不存在高度依赖少数供应商的情形。

**七、2017 年度，你公司汇兑收益为-1,416.47 万元，同比下降 164.88%，请说明你公司是否已针对汇率大幅波动采取必要的风险应对措施。**

回复：

公司产品销售以出口为主，主要以美元进行结算，在汇率波动较大时会对公司的经营业绩造成重大影响，故公司予以高度关注，并结合自身实际情况，采取了如下必要措施：

- 1、销售定价时，尽可能考虑未来汇率变动可能带来的汇率损失风险；
- 2、尽量缩短账期，积极催收货款，通过降低公司应收账款外币货款来减少汇率波动对经营情况的影响幅度；
- 3、未来拟通过与银行进行远期结汇交易转移汇率风险。

**八、2017 年末，你公司长期借款账面余额为 2.67 亿元，较期初上升 90.71%，请说明本期新增长期借款的具体用途，以及长期借款余额大幅增长的合理性。**

回复：

2017年末，公司长期借款账面余额为2.67亿元，较期初上升90.71%。主要是由于2017年度本公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国银行股份有限公司深圳市分行分别签订了借款金额为2亿元、1.5亿元的固定资产借款协议，借款期限为5年，上述长期借款均用于“TPI薄膜碳化技术改造项目”的建设（含设备采购）。

“TPI薄膜碳化技术改造”项目，是依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。开展PI碳化膜方面的研究，拓宽新材料的应用领域，抢占高端材料制高点，是丹邦公司重大战略布局。

其必要性主要体现在，1) 为我国抢占产业制高点，实现全球技术领先，2) 顺应国家战略布局，打造先导产业，3) 实现石墨烯薄膜规模化生产，巩固先发优势，4) 为公司提升经营业绩，持续较快发展。该项目计划总投资5.71亿元，实施过程中在自有资金无法满足时，通过向金融机构借款取得相应的资金支持。也使得公司2017年末账面长期借款较期初有大幅增加。

**九、2017年末，你公司一年内到期的长期借款余额为1.4亿元，同时你公司流动比率仅为0.73。请结合你公司的经营现状和资金安排，说明你公司目前是否存在不能偿还到期债务的风险。**

回复：

公司目前的营业收入主要来源于FPC、COF 柔性封装基板、COF产品及微电子级高性能聚酰亚胺薄膜产品的销售。

其中：1) FPC、COF 柔性封装基板及COF产品为公司传统主营业务，2017年度实现销售额3.04亿元，较2016年度增加3,619.53万元，增涨13.53%；2) 微电子级高性能聚酰亚胺薄膜产品为公司募投项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”，该项目于2017年陆续达到可量产状态，并少量对外销售，2017年度实现销售额992.43万元。该项目年度完全达产的情况下，预计PI膜年产量300吨，目前市场同类PI膜采购单价为500元/公斤，因此2018年度PI膜正常完全达产对外销售的情况下可以给公司带来较大的收入增涨及销售回款。

同时，2017年公司为了延长产业链，提升产品附加值，实现公司利益最大化，在依托公司自产化学法微电子级PI膜的基础上，对PI碳化膜方面展开的深入研究及产业布局。目前，公司已经完成碳化膜样品的开发及性能测试等前期工作，进

入产业化准备阶段。由于TPI碳化膜市场销售较PI膜具有更高的回报值，因此在TPI碳化膜产品投产入市时，相比PI膜销售会给公司收入、利润及回款带来更大的增涨。

综上，虽然公司一年内到期的长期借款余额为1.4亿元，同时流动比率仅为0.73，但公司主营业务部分为偿还到期借款提供了充足的资金来源，且公司非常注重融资风险，在借款时，已充分考虑还款过度集中的情况，公司一年内到期的长期借款偿还时各期单笔还款均不超过2000万元，故不存在不能偿还到期债务的风险。

十、2017年末，你公司应付账款余额为1,665.58万元，较期初下降44.95%，请结合你公司经营现状和供应商的信用政策，说明应付账款余额大幅下降的原因。

回复：

2017年末，应付账款按款项性质列示如下：

| 单位：万元  |          |          |           |         |
|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 款项性质   | 期末余额     | 期初余额     | 变动金额      | 变动比例    |
| 材料款    | 1,293.36 | 2,272.05 | -978.69   | -43.08% |
| 设备、工程款 | 359.32   | 665.37   | -306.05   | -46.00% |
| 其他     | 12.90    | 88.26    | -75.35    | -85.38% |
| 合计     | 1,665.58 | 3,025.67 | -1,360.09 | -44.95% |

上述数据可以看出，2017年末公司应付账款余额1,665.58万元，较2016年末下降44.95%，主要是由于2017年末应付材料款及设备、工程款减少所致。

其中，期末应付材料款较2016年末减少978.69万元，下降43.08%，主要是由于2017年与客户黑田電気业务模式发生变化，其业务模式由客户指定性进料采购加工业务转变为公司自行采购加工，原客户指定性进料采购与客户销售回款享有同等信用周期，但采购成本较高。2017年为节约采购成本，提高产品利润率，经与客户充分协商，2017年其业务模式由客户指定性进料采购加工转变为公司自行采购加工。其业务模式的转变带来供货及结算方式的改变，使得期末账面应付材

料款较2016年末存在较大波动。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2018年6月22日